

Piikiekkovalmistaja Okmeticilta jälleen uusi tuote matkapuhelinten suodinmarkkinoille - UF-RFSi[®] -kiekko täydentää yhtiön korkearesistiivistä RFSi[™] tuoteperhettä ja vastaa 5G:n tuomiin haasteisiin

Teknologiayhtiö Okmetic on lanseerannut uuden TF-SAW-suotimia varten räätälöidyn UF-RFSi[®] (Ultra Flat Radio Frequency Silicon Wafer) piikiekkon täydentämään yhtiön korkearesistiivistä RFSi[™] (Radio Frequency Silicon) tuoteperhettä. Okmeticin tuoteperheen tuotteet tarjoavat erinomaisen alustan erilaisille RF-sovelluksille kuten matkapuhelimissa käytettäville BAW- ja TF-SAW-suotimille ja IPD-sovelluksille, joiden kysyntää 5G:n tuleminen vauhdittaa. Sekä UF-RFSi[®] -kiekolle että RFSi[™]-tuoteperheelle on haettu tavaramerkkiä, sillä niistä odotetaan samanlaista menestystarinaa kuin yhtiön (Silicon-On-Insulator) SOI-kiekoista.

”Okmetic on toimittanut RF-suotimiin ja -sovelluksiin jo lähes 2 miljoonaa piikiekkoa, ja arvioimme RFSi[™]-piikiekkojen toimitusten lähes kaksinkertaistuvan vuonna 2021 suodinten ja muiden RF-sovellusten kysynnän kasvun myötä. UF-RFSi[®] sopii erinomaisesti Okmeticin korkeakatteisten erityistuotteiden strategiaan ja lanseeraus osuu oikeaan saumaan, sillä TF-SAW-suotimien odotetaan yleistyvän nopeasti matkapuhelimissa,” Okmeticin toimitusjohtaja **Kai Seikku** kertoo. Tällä hetkellä matkapuhelimissa käytetään pääasiallisesti BAW- ja SAW-suotimia, mutta TF-SAW suotimien ennakoitaan kasvattavan kysyntäänsä nopeasti hyvän suorituskyky-hintasuhteensa vuoksi. Okmeticin RFSi[™]-tuoteperheen tuotteet soveltuvat etenkin BAW- ja TF-SAW-suotimien alustaksi.

RF-radiotaajuusmarkkinat ovat kasvaneet nopeasti viime vuosien aikana 4G:n ja 5G:n vauhdittamana, ja puolijohdealan analytiikkoyhtiö Yole Développement ennustaa RFFE-markkinoiden (radiotaajuusteollisuuden etupää) saavuttavan 26 miljardin Yhdysvaltain dollarin tason vuoteen 2025 mennessä. 5G:n tuleminen lisää matkapuhelimissa tarvittavien suotimien määrää ja teknologiavaatimuksia entisestään. Suotimia tarvitaan matkapuhelimissa erottamaan taajuusalueita ja kontrolloimaan datansiirtoa, jotta vältetään häiriöitä ja matkapuhelimen hitaalta käyttökokemukselta.

UF-RFSi[®] - markkinoiden ensimmäinen kiekko TF-SAW-suotimiin

UF-RFSi[®] on markkinoiden ensimmäinen korkearesistiivinen piikiekko ultratasaisilla ominaisuuksilla, minkä vuoksi se soveltuu erityisen hyvin matkapuhelimissa käytettävien TF-SAW-suotimien valmistamiseen, joiden kysyntää 5G:n yleistymisen vauhdittaa. UF-RFSi[®]-kiekossa yhdistyvät Okmeticin edistyksellisen A-MCz[®]-kiteenkasvatusteknologian mahdollistama ennennäkemätön tekninen suorituskyky, korkearesistiivisyys ja matalahäviöisyys.

”UF-RFSi[®] on markkinoiden ensimmäinen kiekko, joka on räätälöity etenkin TF-SAW-suotimien tarpeisiin. Tämä innovaatio antaa asiakkaille mahdollisuuden valmistaa kaikista vaativimpia aktiivikerroksien geometrioita kustannustehokkaasti. Kiekkon pitkälle viety muokattavuus mahdollistaa

korkean suorituskyvyn ja kustannustehokkuuden monenlaisissa suodin- ja RF-tekniikan sovelluksissa,” sanoo teknologiajohtaja **Atte Haapalinna**.

UF-RFSi[®]-piikiekossa yhdistyvät vakaa resistiivisyys, matala kytkentähäviö (insertion loss) ja erinomaiset lineaariset ominaisuudet kuten vähäinen harmoninen ja keskinäismodulaatiosärö (2nd harmonics, IMD3 intermodular distortion), mikä tekee siitä erittäin kilpailukykyisen vaihtoehdon kilpaileviin teknologioihin verrattuna. UF-RFSi[®]-kiekon erinomainen RF-suorituskyky sekä erinomainen planarisaatiotehokkuus tekee TF-SAW-suotimien hybridirakenteiden valmistamisesta entistä helpompaa. Lisäksi tuote pystytään räätälöimään täysin asiakkaan tuote- ja prosessitarpeisiin sopivaksi.

Okmeticin UF-RFSi[®] -kiekko ja RFSi[™]-tuoteperhe ovat jälleen erinomainen esimerkki suomalaisesta insinööriosaamisesta ja pitkän linjan T&K-työstä. Erikoiskiekkojen kysynnän kasvu on ollut nähtävissä jo pitkään ja yhtiö pyrkii vastaamaan tähän kysyntään Vantaan tehtaassa kapasiteetia ja henkilöstöä kasvattamalla. Okmeticin yli 100 miljoonan euron investointiohjelma Vantaan tehtaalle vuosien 2017-2021 aikana on loppusuoralla. Investoinnin myötä lisääntynyt kapasiteetti antaa Okmeticille mahdollisuuden vastata kasvavaan erikoiskiekkojen kysyntään entistä paremmin,” toteaa **Kai Seikku** lopuksi.



Okmeticin UF-RFSi[®] on räätälöity piikiekko, joka soveltuu etenkin matkapuhelimissa käytettävien TF-SAW-suotimien alustaksi.

Vantaalla 31.3.2021

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Seikku
Puh. 040 020 0288, kai.seikku@okmetic.com

Teknologiajohtaja Atte Haapalinna, Okmetic
Puh. 09 502 800 / 09 502 80 474, atte.haapalinna@okmetic.com

Viestintäpäällikkö Marika Mäntymaa, Okmetic
Puh. 040 069 7882, marika.mantymaa@okmetic.com

Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä, korkean lisäarvon piikiekoja antureiden sekä erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen. Okmeticin asiakkaiden valmistamat tuotteet päätyvät lukuisiin meitä ympäröiviin loppusovelluksiin kuten älypuhelimet, kannettavat laitteet, autoelektronikka,

LEHDISTÖTIEDOTE 31.3.2021

teollisuuden prosessikontrollon ja lääketieteen sovellukset, Internet of Things (IoT) sekä erilaiset tehonsyötön ja hyötysuhteiden parantamiseen liittyvät ratkaisut.

Maailmanlaajuinen myyntiverkosto, laaja tuoteportfolio, kiteenkasvatus- ja SOI-kiekkosaaminen, tehokas ja joustava tuotanto sekä pitkäaikaiset tuotekehityshankkeet luovat edellytykset kannattavalle kasvulle. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, missä valmistetaan myös valtaosa yhtiön piikiekoista. Lisäksi yhtiöllä on sopimusvalmistusta Aasiassa. Okmeticin vuoden 2020 liikevaihto oli 108 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 500 henkilöä.

Okmetic on ollut osa kiinalaista NSIG:tä (National Silicon Industry Group) vuodesta 2016 lähtien.

www.okmetic.com